

Title (en)
Printing Plate and Method for its' Preparation

Title (de)
Druckklischee und Verfahren zur Herstellung

Title (fr)
Plaque d'impression et procédé pour sa fabrication

Publication
EP 1172227 A1 20020116 (DE)

Application
EP 01106865 A 20010320

Priority
DE 10033629 A 20000711

Abstract (en)
The printing plate for indirect deep printing or tampon printing method has an engraving, a support and a cover layer on the support. The cover layer is a layer usable with a laser. The support is a metal block or a metal foil, and has a preferred thickness of 0.1mm to 0.5mm. The lacquer has a preferred thickness of 0.1 to 0.3mm. The lacquer is of the single or multi-component type. Mixed with it are the following additives:- primer, hardener, thinner, surface tension reducer, air remover, foam remover, viscosity or thixotrophy influencing agent. The thickness of the laser engraving is less than the thickness of the lacquer layer or can in areas be greater.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Druckklischee für das indirekte Tiefdruck- oder Tampondruckverfahren, wobei das die Gravur aufweisende Klischee einen Träger und eine auf dem Träger vorgesehene Deckschicht aufweist. Die Erfindung betrifft außerdem ein Verfahren zum Herstellen eines derartigen Druckklischees zum Herstellen eines derartigen Druckklischees und eine erfindungsgemäße Verwendung des Druckklischees.

IPC 1-7
B41N 1/06; **B41C 1/05**; **B41M 5/24**

IPC 8 full level
B41C 1/05 (2006.01); **B41M 5/24** (2006.01); **B41N 1/06** (2006.01); **B41M 5/26** (2006.01)

CPC (source: EP)
B41C 1/05 (2013.01); **B41N 1/06** (2013.01); **B41M 5/24** (2013.01)

Citation (search report)
• [X] DE 19544272 A1 19970605 - SAUERESSIG GMBH & CO [DE], et al
• [X] DE 19633643 A1 19980305 - SCHEPERS DRUCKFORMTECHNIK GMBH [DE]
• [X] EP 0584857 A2 19940302 - METALLGESELLSCHAFT AG [DE]
• [X] EP 0466433 A2 19920115 - SONY CORP [JP]
• [X] PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 2000, no. 01 31 January 2000 (2000-01-31)
• [X] PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 2000, no. 05 14 September 2000 (2000-09-14)

Cited by
WO2016177702A1; EP3460098A1; CN108093630A; WO20240272A1; WO2006061053A1; US10792909B2

Designated contracting state (EPC)
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE TR

DOCDB simple family (publication)
EP 1172227 A1 20020116; DE 10033629 A1 20020131; DE 10033629 B4 20111201

DOCDB simple family (application)
EP 01106865 A 20010320; DE 10033629 A 20000711